



证券代码：300567

证券简称：精测电子

编号：2026-003

武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	华西证券黄瑞连、钟一新、徐一凯；长江证券杨洋、王泽罡、倪蕤、石聪；国联民生李哲、周晓萌、王海；华源证券葛星甫、何理、傅雨蓉、钟依浓；西部证券段倩、王昊哲、陈彤、徐凡；中信证券程子盈、李文涛；招商证券郭倩倩、王焱仟、张蓓；浙商证券厉秋迪、姜守全、陈俊韬、沈钱、胡嘉；国信证券叶子、王鼎、张炜、刘佳奇；国海证券杜先康；广发证券解丰源、许贝尔；财通证券余炜超、王雨然、谢铭、黄梦龙、柳婧舒、赵晖；华泰证券吕兰兰、方志奇；天风证券朱晔、唐梦涵、陈磊；华创证券范益民、丁祎；易方达基金李凌霄；南方基金郑晓曦、吴春林、刘葳洋、万朝辉；博时基金刘宁、王赫；华夏基金杨雨润；申万菱信基金付娟、卜忠林；宝盈基金游凡；嘉实基金孟丽婷、王贵重；摩根士丹利基金李子扬；中欧基金张杰；中银基金宋方云、李倩倩、陈婷婷、王虹宇；光大保德信基金林晓凤、王霄鸿；平安基金方军平；中国人保吴若宗；太平养老黄强等 326 余人（排名不分先后）
时间	2026 年 4 月 27 日
地点	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、显示及新能源事业群总经理：刘荣华先生 董事、副总经理、董事会秘书：刘炳华先生 财务负责人：游丽娟女士



	上海精测投融资总监：李国先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：公司 2025 年、2026 年第一季度主要经营情况介绍？</p> <p>A：2025 年，公司紧抓半导体设备国产化替代的关键窗口期，持续巩固并提升在半导体量检测领域的国内领先地位，进一步加大对先进制程领域（28nm 以下）的研发投入与产品布局。随着前期高强度研发投入逐步进入业绩兑现阶段，公司技术产业化进程全面提速，半导体领域主营产品均实现规模化量产，交付能力大幅增强，收入确认规模同比显著增长。与此同时，公司持续优化业务结构、提升经营效率，推动半导体板块盈利能力显著改善，新签订单、营业收入、净利润均实现同比大幅增长。在平板显示业务方面，2025 年行业复苏态势持续延续，终端应用需求稳步回暖，受益于 LCD 大尺寸及超大尺寸产能扩张、国内头部客户 G8.6 代生产线投建，以及 OLED 领域资本开支上行，行业检测设备需求景气度持续走高。2025 年，公司平板显示检测业务实现快速增长，叠加客户结构与产品结构的持续优化，业务毛利率明显提升，盈利能力显著增强。</p> <p>在新能源业务板块方面，2025 年仍面临亏损压力与经营挑战。此外，2025 年公司投资收益相较于去年同期进一步减少（公司联营企业湖北星辰主要布局先进封装领域，目前处于快速投入期，2025 年湖北星辰投资收益亏损 4,957 万元，相较于去年同期亏损同比增加 64%），对公司经营业绩形成一定拖累。后续公司将针对性优化调整整体业务结构，集中资源聚焦半导体等核心优势领域，聚力做强主业，进一步提升整体经营效益。</p> <p>2025 年，公司实现营业收入 334,763.76 万元，同比增长 30.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,202.07 万元，成功实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 17,961.92 万元；2025 年末公司总资产为 1,165,266.23 万元，较期初增长 15.64%；归属于上市公司股东的净资产为 434,168.15 万元，较期初增加 25.34%。2026 年第一季度，公司</p>



实现营业收入 73,946.98 万元，较上年同比增长 7.26%；实现归属上市公司股东的净利润 4,271.20 万元，较上年同比增长 13.61%。

Q2：公司各个板块在手订单情况。

A：截至《2025 年年度报告》披露日，公司取得在手订单金额总计约 42.31 亿元，其中半导体领域在手订单约 25.33 亿元、显示领域在手订单约 9.79 亿元、新能源领域在手订单约 7.19 亿元。半导体领域在手订单占公司订单比例接近 60%，半导体业务已成为公司经营业绩的核心支撑。

Q3：2025 年公司研发投入情况如何？

A：公司继续保持研发投入强度，研发投入 81,185.91 万元，较上年同期增长 11.12%，占营业收入 24.25%。其中，半导体量检测领域研发投入 46,547.73 万元，较上年增长 30.03%；显示检测领域研发投入 30,974.84 万元，较上年下降 1.76%；新能源领域研发投入 3,663.35 万元，较上年下降 36.13%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已取得 2,627 项专利（其中 1,239 项发明专利，983 项实用新型专利、405 项外观设计）、396 项软件著作权、34 项软件产品登记证书、92 项商标（其中国际商标 26 项）。

Q4：公司半导体量检测领域发展现状如何？

A：2025 年，公司半导体领域订单、营收均主要来源于前道量检测领域，前道量检测领域订单、营收占半导体领域整体九成以上，后道检测等领域处于市场导入深化阶段，占公司半导体领域营收和订单的比例较低。2025 年公司在整个半导体板块实现销售收入 131,777.32 万元，较上年同期增长 71.60%；归母净利润 11,222.06 万元，成功实现扭亏为盈，归母净利润较上年同期增加 14,262.68 万元；公司在半导体领域毛利率为 49.65%，较上年同期上升 3.90 个百分点。

公司半导体前道量测领域膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备为核心



产品均处于国内行业领先地位，其中膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备等部分主力产品已完成 7nm 先进制程的交付及验收，目前更加先进制程的产品正在验证中。2025 年，公司应用于先进制程领域（28nm 以下，不含 28nm）新签订单占半导体领域新签订单超六成，先进制程产品占公司整体营收和订单的比例不断增加，现已成为公司半导体前道量检测领域业绩的核心驱动力。

公司聚焦 ATE 领域持续深耕，构建起覆盖先进存储、SOC（系统级芯片）以及第三代功率半导体的全场景测试体系，为不同领域客户提供定制化、高效可靠的系统测试解决方案。面向先进存储芯片，可提供集成 BI（Burn-In）测试、CP（Chip Probing）测试和 FT（Final Test）测试于一体的多场景测试方案，并已完成迭代升级支持 UFS4.1 的测试。同时全新推出 JH5520 HBM BI 测试系统，精准满足 HBM 高端存储测试需求。面向系统级芯片，ATE 自动完成对集成电路功能、性能及可靠性的测试，广泛应用于芯片的设计验证、晶圆测试（CP）和成品测试（FT）环节。相关产品进展详见公司《2025 年年度报告》。

在先进封装量检测领域，公司于 2024 年 3 月通过投资湖北星辰深度布局半导体先进封装领域，目前湖北星辰已建成国内领先的 12 英寸集成电路先进封装研发线，核心工艺已全面贯通，正在进行客户导入与小批量生产，可为客户提供一站式先进封装成套解决方案。湖北星辰已启动量产产线建设，旨在为客户提供充足产能保障。湖北星辰对标国际领先先进封装工艺平台，持续开展技术研发与攻关，已同时具备中、高密度先进封装全套工艺技术，并在互联间距、互联密度、功耗等方面拥有领先优势，可为多类应用场景需求下不同领域客户提供产品定制化解决方案。

随着先进封装装备技术快速迭代，部分前道工艺向封装环节延伸，拉动半导体前道量检测、刻蚀、薄膜沉积、键合等设备的需求。面对 2.5D/3D 等先进封装挑战，公司现有前道量检测设备（主要包括膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、明场光学缺



陷检测设备为核心产品，具体详见前道量检测设备相关产品情况）已全部导入先进封装产线。

此外，公司晶圆外观检测设备主要专注于 CMOS 图像传感器、AR/VR、Logic、MEMS、Memory、RF、Power、FOWLP、WLCSP、Bumping、Chiplet 等先进封装工艺的有图形硅晶圆和无图像玻璃晶圆检测，已完成小批量出货，目前正在积极开发面向先进制程的 3D 量测，并与国内头部客户进行紧密验证测试。针对晶圆亚微米级缺陷进行检测与量测，集成高精度明暗场成像技术和专业缺陷检测算法，同时可扩展升级到晶圆 Bumping 及 Mirco-LED 3D 量测，有效服务客户提升制造能力指数与生产效率，精准适配先进封装快速发展带来的复杂缺陷检测需求。

Q5：公司显示检测领域发展现状如何？

A：公司产品覆盖 LCD、OLED、Micro OLED、Mini/Micro-LED 全制程检测设备，国内市场占有率领先，深度配套京东方、TCL 华星光电、天马微电子、莱宝高科、维信诺、和辉光电、OPPO、惠科股份、视涯股份、显耀显示等国内主流面板厂商，以及三星、LG、Apple、Meta 等海外头部客户。2025 年，受益于消费领域头部客户 IT 类产品逐步使用 OLED 屏幕带来的行业风向标，国内龙头企业京东方、TCL 华星光电、维信诺 G8.6 OLED 项目的投建，LCD 大尺寸、超大尺寸扩线投资需求以及公司产品竞争力的进一步提升等多重因素叠加影响，公司在显示领域实现营业收入 175,475.53 万元，相较于去年同比增长 10.31%；实现归母净利润 20,629.20 万元，相较于去年同比增长 223.46%；公司在显示领域毛利率为 46.31%，较上年同期上升 7.95 个百分点。截至《2025 年年度报告》披露日，公司在显示领域在手订单约 9.79 亿元。

公司在新型显示以及智能和精密光学仪器领域取得明显进展，深度集成显示颜色测量技术、图像均匀性校准技术、高速数据处理技术、电性测试技术等核心能力，自研多款高端精密检测



仪器，实现从传统显示到新型显示产线与实验室的全领域、全应用、全场景量检测服务覆盖。推出多点光谱增强色度计、多视角光谱测量仪、近眼显示高精度光谱仪、近眼显示色度计、近眼显示成像式光谱仪等智能光学仪器产品，攻克视角测量光谱偏移导致测量误差、多分区测量光谱失配等行业痛点，实现产品亮色度、光谱数据、视角、Gamma 调测、颜色均一性等测量，并系统展示多款精密光学/电学仪器，为复杂环境下的检测提供高效可靠的解决方案。现阶段部分精密光学/电学仪器已实现较大规模的销售，未来将对显示领域的快速发展提供重要的支撑。

公司深耕 AR/VR 领域，聚焦海外头部客户核心需求，依托精密仪器至光学检测系统全链条自主开发能力，构建起一站式全流程检测服务体系，为海外头部客户提供定制化、高可靠性的检测解决方案。公司凭借自主研发的核心技术优势，在海外 Top 客户的 VR 项目 Micro OLED 微显示、AR 项目 Display Engine 光引擎、Eyepiece 目镜模组及 FATP 整机组装制程检测等关键环节检测项目中深度合作，持续收获订单，彰显一站式自主服务核心竞争力，进一步巩固海外 AR/VR 检测领域市场地位，为业务全球化布局奠定坚实基础。

Q6：公司新能源设备领域发展现状如何。

A：现阶段，公司在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备，主要用于锂电池电芯组装配和检测环节等，包括锂电池切叠一体机、CT&XRAY 无损检测机、化成分容系统、CIR 组装配线、锂电池视觉检测系统和 BMS 检测系统等。2025 年，公司进一步加强与核心战略客户在锂电设备领域的深度合作，共同研发迭代产品，提升双方产业竞争力；同时，公司通过加强人员培训，优化调整组织结构及流程提升内生动力等多种举措，进一步提升公司核心竞争力。此外，公司正积极开拓与国内外知名电池厂商的合作关系，特别是海外核心客户的合作关系。2025 年，公司新能源业务仍面临亏损的压力与挑战，新能源领域实现销售



收入 16,883.13 万元，较上年同比增长 1.09%；归母净利润亏损 8,586.25 万元，相较于去年同期亏损同比增加 50.29%；公司在新能源领域毛利率为 27.41%，较上年同期下降 3.40 个百分点。针对新能源领域持续亏损的不利局面，公司持续优化业务结构，并对管理团队进行调整，已取得积极效果，截至《2025 年年度报告》披露日，公司在新能源领域在手订单约 7.19 亿元。

Q7：公司收购上海精积微少数股东股权事项介绍。

A：公司于 2026 年 4 月 26 日召开第五董事会第十二次会议，审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司与上海精积微股东上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州芯兆创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴浦测股权投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙）、南京创盈盛通股权投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》。本次交易完成后，公司进一步提升半导体领域核心资产持股比例，将直接持有上海精积微 22.5355% 的股权，通过上海精测持有上海精积微 27.2168% 的股权（注：鉴于公司控股子公司上海精测分别同上海精积微原股东上海精望企业管理中心（有限合伙）、海宁市精海股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《股东表决权委托协议》，因此上海精测持有上海精积微的表决权比例为 59.8769%），上海精积微仍为公司合并报表范围内公司。

上海精积微现阶段主要聚焦明场晶圆有图形缺陷检测设备以及暗场缺陷检测设备领域相关产品的研究开发以及生产制造等。公司基于对未来长远战略规划和经营发展需要，通过受让上海精积微少数股东股权提高持股比例，有利于公司深化对半导体量检测业务板块的整合与管理，更好地实现协同效应，保障公司的可持续发展。



	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 4 月 27 日